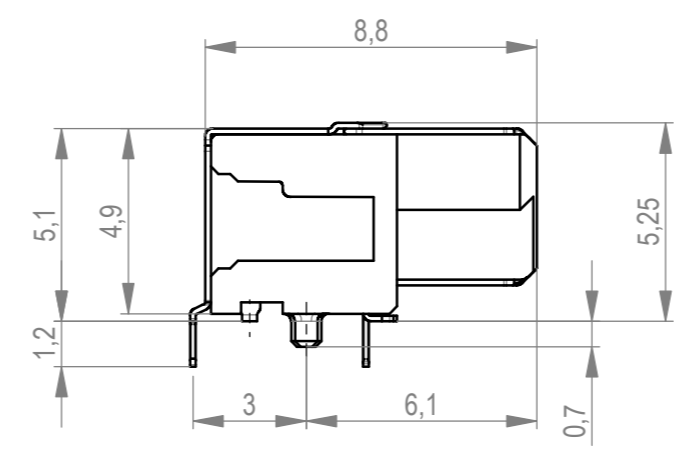
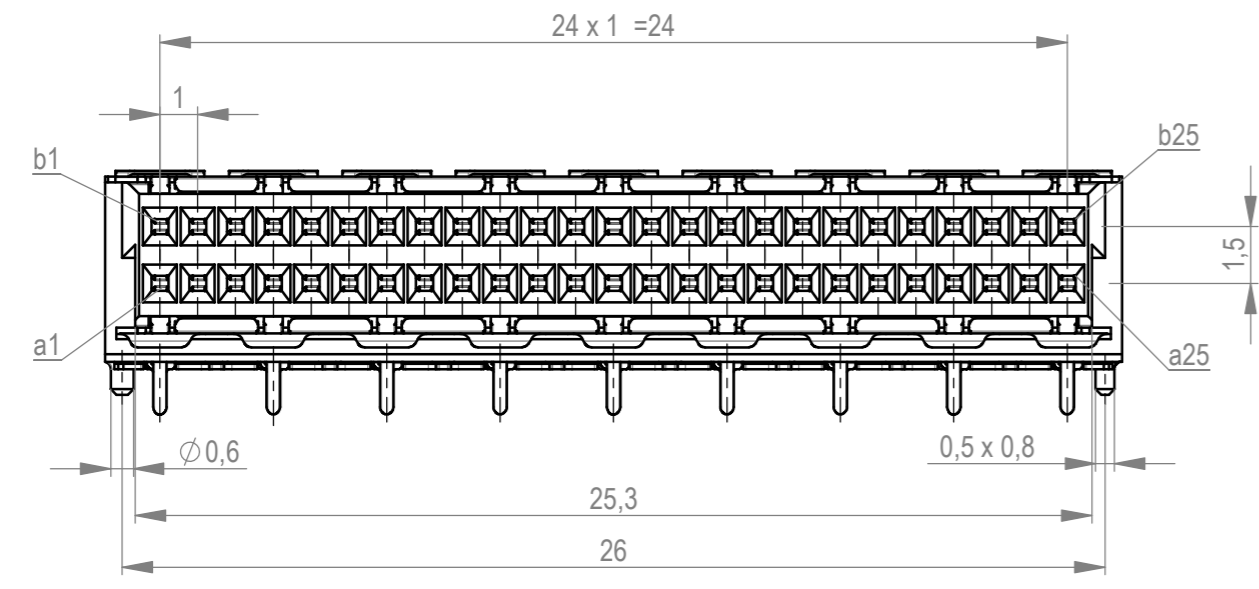
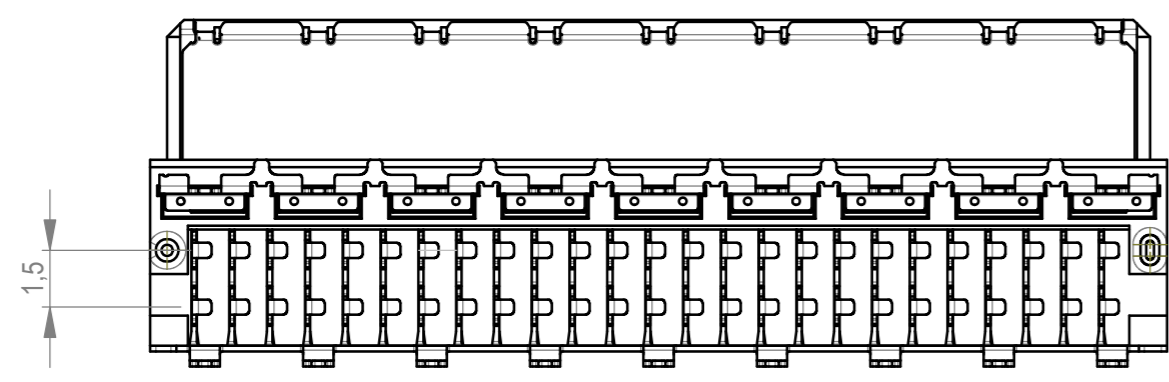
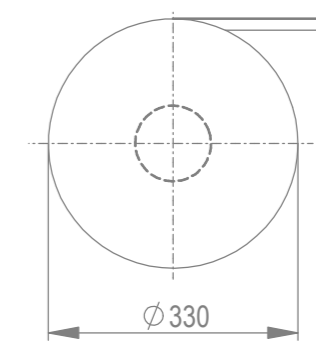
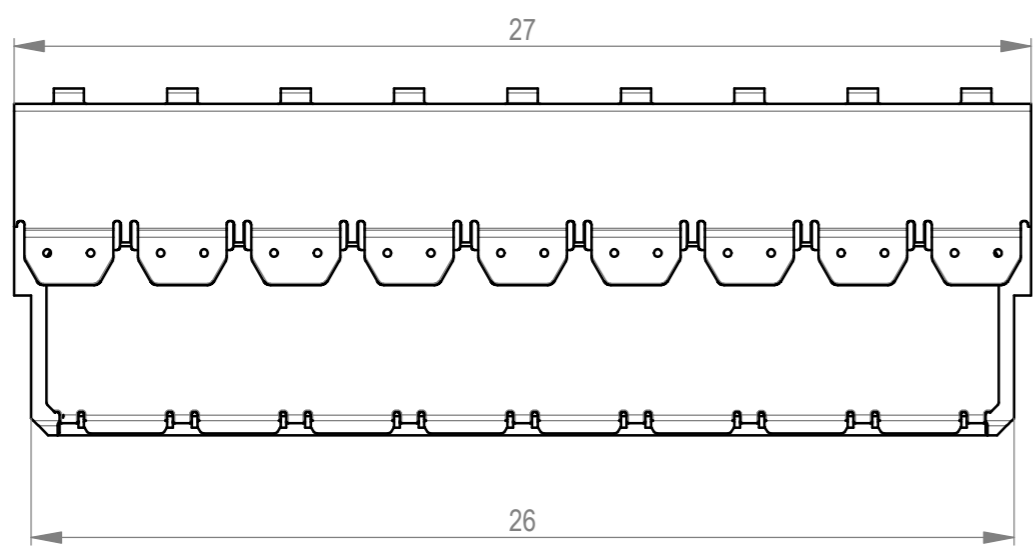
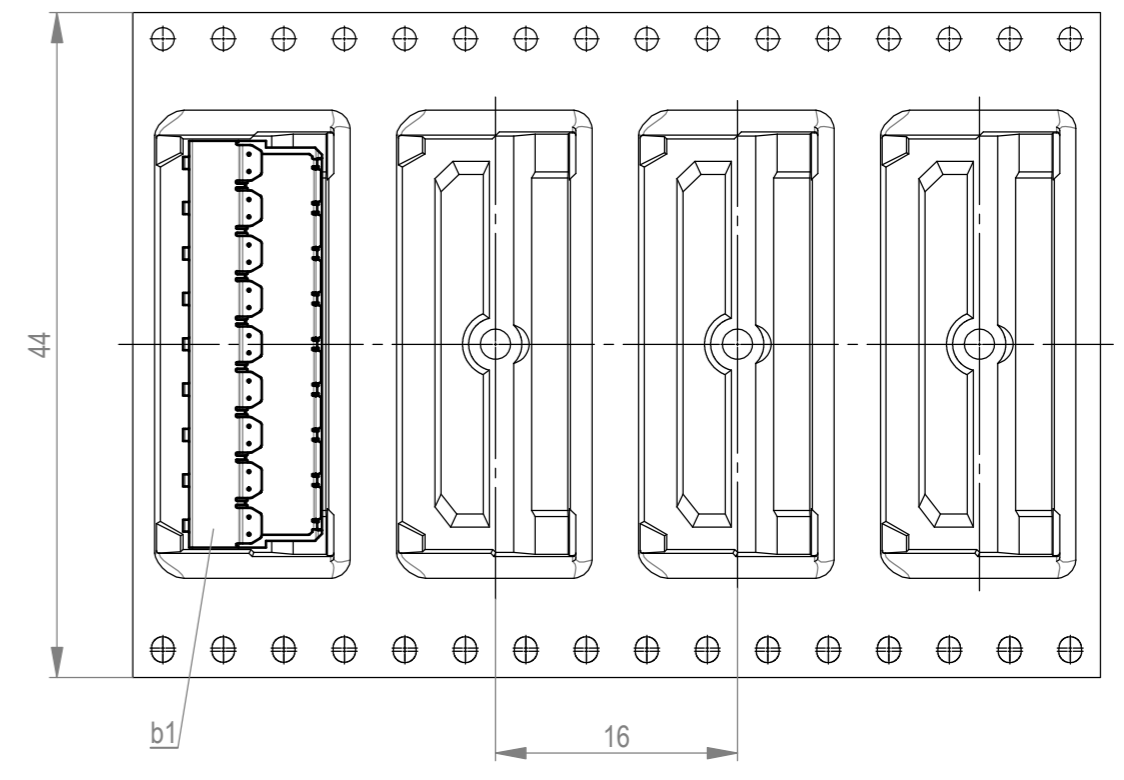


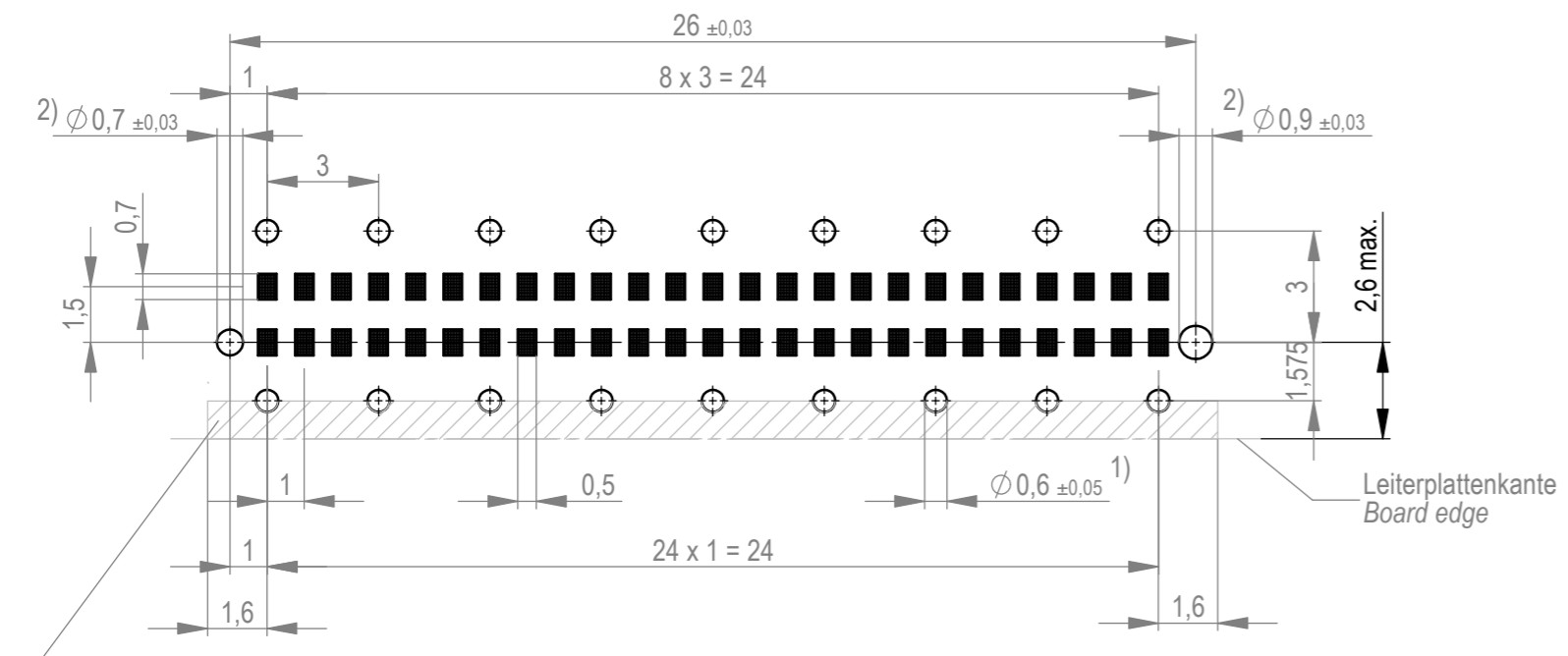
Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 500 Stück
 packaging unit: 500 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal



1) Fertigllochdurchmesser / Finished Via diameter
 2) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Schirmblechauflagefläche berücksichtigen,
 keine Durchkontaktierungen oder Leitungen möglich!
 Consider shielding contact area, no via's or traces possible!

Anforderungsstufe 1
 performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
 mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
 coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Weder die Zeichnung noch die Beschreibung sind verbindlich. Bei Änderungen von dem englischen Original gilt das englische Original. No drawing has been created for convenience only and may deviate from the original. In case of any deviation the English version shall prevail. Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handlung. Bei Änderungen von dem englischen Original gilt das englische Original. No drawing has been created for convenience only and may deviate from the original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.	Tolerances ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1 Material
Customer drawing: This Drawing is a controlled Document.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Federl. 90° SMDTHR 50-pol. EMV Female 90° SMDTHR 50 cont. EMV
f1 Index	18.05.2023 Date	TE Connectivity	C A2
Class			MSPEED